

杭州士兰微电子股份有限公司

关于为控股子公司提供日常担保的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 担保对象及基本情况

担保对象	被担保人名称	杭州士兰集昕微电子有限公司（以下简称“士兰集昕”）
	本次担保金额	10,000.00 万元
	实际为其提供的担保余额（截至 2025 年 11 月 30 日）	79,549.50 万元
	是否在前期预计额度内	√是 □否 □不适用：_____
	本次担保是否有反担保	□是 √否 □不适用：_____

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额（万元）	0
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额（万元）	516,581.10
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）	42.29

一、担保情况概述

（一）年度预计日常担保进展情况

2025 年 11 月 1 日至 2025 年 11 月 30 日，杭州士兰微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）在年度预计日常担保额度内实际签署的担保合同如下：

担保合同 签署日期	担保合 同名称	保证人	被担保人	债权人	担保金额	担保 方式	担保期限
2025 年 11 月 13 日	最高额 保证合 同	杭州士兰 微电子股 份有限公 司	杭州士兰 集昕微电 子有限公 司	杭州银行 股份有限 公司浙江 自贸区杭 州江南支 行	担保的最高融资 余额为人民币 10,000.00 万 元 及其利息、费用 等	连带 责任 保证 担保	主合同项下每一笔具 体融资业务的保证期 限单独计算，为自具体 融资合同约定的债务 人履行期限届满之日 （如因法律规定或约 定的事件发生而导致

							具体融资合同提前到期，则为提前到期日）起叁年
--	--	--	--	--	--	--	------------------------

本次担保无反担保。本次担保非关联担保。士兰集昕其他股东未提供担保。

截至 2025 年 11 月 30 日，公司为士兰集昕实际提供的担保余额为 79,549.50 万元；公司日常担保余额为 161,156.28 万元，剩余可用担保额度为 128,843.72 万元；担保余额在公司 2024 年年度股东大会批准的年度预计日常担保额度范围内。

（二）本次担保事项履行的内部决策程序

公司于 2025 年 4 月 17 日召开的第八届董事会第三十二次会议和 2025 年 6 月 12 日召开的 2024 年年度股东大会审议通过了《关于 2025 年度对子公司提供日常担保额度的议案》，同意公司在 2025 年度对资产负债率为 70%以下的主要全资子公司及控股子公司提供日常担保的总额度不超过 29 亿元。实际发生日常担保时，公司可以在上述预计的日常担保总额度内，对资产负债率为 70%以下的不同控股子公司（包含年中新增或新设的控股子公司）进行相互调剂。本次担保预计金额包含以前年度延续至 2025 年度的日常担保余额。本次担保预计额度自 2024 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，如公司 2025 年年度股东大会与 2024 年年度股东大会间隔超过 12 个月的，在 2025 年年度股东大会召开前，本公司为上述全资子公司及控股子公司在以上担保的总额度内所作出的担保依然有效。股东大会同时授权董事长陈向东先生审批具体的担保事宜并签署相关法律文件。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 19 日和 2025 年 6 月 13 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告，公告编号为临 2025-008、临 2025-014 和临 2025-028。

本次担保在上述股东大会批准的担保额度范围内，无须另行召开董事会及股东会审议。

二、被担保人基本情况

被担保人类型	☒ 法人 ☐ 其他_____（请注明）
被担保人名称	杭州士兰集昕微电子有限公司

被担保人类型及上市公司持股情况	☐ 全资子公司 ☒ 控股子公司 ☐ 参股公司 ☐ 其他_____（请注明）		
主要股东及持股比例	本公司直接持有 55.54% 杭州集华投资有限公司（以下简称“集华投资”）直接持有 41.24% 杭州士兰集成电路有限公司（以下简称“士兰集成”）直接持有 3.22% （本公司通过集华投资间接持有 41.24%，通过士兰集成间接持有 3.19%）		
法定代表人	陈向东		
统一社会信用代码	91330101MA27W6YC2A		
成立时间	2015 年 11 月 4 日		
注册地	浙江省杭州市钱塘区 10 号大街（东）308 号 13 幢		
注册资本	224,832.8735 万元		
公司类型	其他有限责任公司		
经营范围	制造、销售：8 英寸集成电路芯片、分立器件芯片、半导体、功率模块；销售：8 英寸集成电路芯片、分立器件芯片、半导体、功率模块相关的原材料，机械设备及零配件、仪器仪表；8 英寸集成电路芯片、分立器件芯片、半导体、功率模块的技术开发、技术转让；货物及技术进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）		
主要财务指标 （万元）	项目	2025 年 9 月末/2025 年 1-9 月 （未经审计）	2024 年末/2024 年度 （经审计）
	资产总额	337,315	341,496
	负债总额	131,745	135,314
	净资产	205,570	206,182
	营业收入	112,001	143,015

	净利润	-612	-5,447
--	-----	------	--------

三、担保协议的主要内容

担保合同名称	保证人	被担保人	债权人	担保金额	担保方式	担保期限
最高额保证合同	杭州士兰微电子股份有限公司	杭州士兰集昕微电子有限公司	杭州银行股份有限公司 浙江自贸区 杭州江南支行	担保的最高融资余额为人民币10,000.00万元及其利息、费用等	连带责任保证担保	主合同项下每一笔具体融资业务的保证期限单独计算，为自具体融资合同约定的债务人履行期限届满之日（如因法律规定或约定的事件发生而导致具体融资合同提前到期，则为提前到期日）起叁年

本次担保无反担保。本次担保非关联担保。

四、担保的必要性和合理性

公司本次担保事项是为了满足控股子公司士兰集昕日常生产经营的资金需求，有利于公司主营业务的发展；被担保人士兰集昕生产经营稳定，资信状况良好，具备偿债能力；公司担保主要系应贷款方要求提供的增信措施，触发担保责任风险可控。

被担保人士兰集昕为公司合并报表范围内的控股子公司，公司对其经营管理、财务等方面具有控制权，能够及时掌握其资信状况和履约能力，担保风险处于公司可控范围内，不会对公司正常经营活动产生重大影响。士兰集昕其他股东集华投资和士兰集成亦为本公司之控股子公司，本公司合计享有士兰集昕 99.97% 所有者权益份额，故其他股东暂无明显提供担保的必要性。因此其他股东未提供同比例担保，不违背公平、对等原则。

本次担保事项符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、董事会意见

公司于 2025 年 4 月 17 日召开的第八届董事会第三十二次会议和 2025 年 6 月 12 日召开的 2024 年年度股东大会审议通过了《关于 2025 年度对子公司提供

日常担保额度的议案》。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 19 日和 2025 年 6 月 13 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告，公告编号为临 2025-008、临 2025-014 和临 2025-028。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司批准对外担保总额为 51.658 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 42.29%，其中：公司对控股子公司提供的担保总额为 42.374 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 34.69%；公司为参股公司厦门士兰集科微电子有限公司提供的担保总额为 9.284 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 7.60%。公司及控股子公司均无逾期的对外担保事项。（注：担保总额包含已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和）

特此公告。

杭州士兰微电子股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 2 日